

2026 年8月 11 日

各 位

会 社 名 ソニーグループ株式会社
代 表 者 名 代表執行役 十時裕樹
(コード番号 6758 東証 プライム)
問い合わせ先 I R 部 I R グ ル ー プ
(TEL:03-6748-2111(代表))

ソニーセミコンダクタソリューションズと TSMC との合弁会社設立に関する確定契約締結のお知らせ

当社の完全子会社であるソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下「ソニー」)は、2026 年5月8日に締結を発表した基本合意書に基づき、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」)との間で、合弁会社(以下「本 JV」)の設立を含む次世代イメージセンサーの開発及び製造に関する戦略的提携(以下「本提携」)について協議を進めてきましたが、本日、TSMC と本 JV の設立に関する法的拘束力のある確定契約を締結したことを発表しました。詳細は、別添プレスリリースをご参照ください。2026 年5月8日付で開示したとおり、本 JV による将来的な投資や、ソニーによる長崎の既存工場への新規投資については、日本政府による支援を受けることを前提に引き続き機動的に検討していきます。

なお、本提携が当社の 2026 年度連結業績に与える影響は軽微です。

以上



2026 年 8 月 11 日

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

ソニーセミコンダクタソリューションズと TSMC、 次世代イメージセンサーにおける合弁会社の設立に関する確定契約を締結

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下「ソニー」)と Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」)は、本日、熊本県合志市を拠点とする合弁会社「Advanced Vision Semiconductor Manufacturing 株式会社」(以下「本 JV」)の設立に関して、法的拘束力を有する確定契約を締結しました。本 JV は、高度な製造プロセス技術を採用したスマートフォン向けイメージセンサーの量産における開発及び製造を担う中核拠点となり、2029 年の量産開始を予定しています。

本 JV は、ソニーが単独の支配株主となり、ソニーグループ株式会社の連結子会社として事業を展開する予定です。なお、本 JV の代表取締役はソニーより選出される予定です。

本確定契約に基づき、本 JV に対して、ソニーは現金出資及び会社分割による資産移管※により約 4,650 億円を拠出し、TSMC は約 2,820 億円の現金出資を行う予定です。これらの資金拠出は、市場の需要や関連する事業環境等に応じて段階的に実行される予定です。両社が拠出するこれらの出資額に加え、本 JV による生産能力の実現に向けた資金計画については、別途、日本政府による支援を受けることを前提として検討を進めています。

両社による戦略的提携の下、ソニーが中心となってイメージセンサーにおけるコア技術の開発、製品企画及び製品設計を担います。その上で、本 JV は、TSMC が有する先端プロセス技術及び製造への専門的な知識・知見を生かし、イメージセンサーの量産における開発及び製造を推進します。これにより、顧客ニーズを起点としたイメージセンサーの製品化を迅速に進めるとともに、技術革新の加速と供給力の強化を目指します。

本 JV の設立及び取引の完了は、関係当局の許認可の取得を含め、一般的なクロージング条件を満たすことが条件となります。

なお、本提携に関するその他の内容については、2026 年 5 月 8 日に公表した「ソニーセミコンダクタソリューションズと TSMC、次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結」に記載のとおりであり、変更はありません。

※ 熊本県合志市における、ソニーが既に投資済みの新工場。



【ソニーセミコンダクタソリューションズについて】

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社は、ソニーグループ株式会社の 100% 子会社であり、イメージセンサーを中心とした半導体デバイス事業を展開。イメージセンサーのリーディングカンパニーであり、個人の生活に利便性や楽しさを提供するイメージング技術に加えて、センシング技術の深化により、人や機械の視覚・認識能力を拡張し、社会や産業における新たな価値創造に貢献しています。詳細は以下をご覧ください: <https://www.sony-semicon.com/ja/index.html>

【TSMC について】

TSMC は 1987 年に設立され、お客様製品の製造を受託する、専業ファウンドリビジネスモデルの先駆者です。業界をリードするプロセス技術と設計支援ソリューションのポートフォリオにより、世界のお客様とパートナーの盛況なエコシステムをサポートし、半導体業界にイノベーションをもたらしています。アジア、ヨーロッパ、北米において事業をグローバルに展開し、世界中で企業市民としての貢献を続けています。

TSMC は、先端ロジック・テクノロジー、スペシャリティ・テクノロジー、先端パッケージング技術など幅広いサービスを提供しています。2025 年には 305 種のプロセス技術を展開し、534 のお客様を対象に 12,682 の製品を製造しました。TSMC は台湾新竹サイエンスパークに本社を置きます。詳細は以下をご覧ください:

<https://www.tsmc.com>
